



■ **5. Electronic System Integration Technology (ESTC) Conference**

16.-18. September 2014, Helsinki, Finnland

IEEE-CPMT und IMAPS haben vor einigen Jahren vereinbart, ihre jeweils im 2-Jahres-Rhythmus stattfindenden Konferenzen auf europäischer Ebene abzustimmen. So wird im Wechsel zu den IMAPS-EMPC (nächstes Jahr in Friedrichshafen) in den geradzahligen Kalenderjahren die Veranstaltungsreihe ESTC von IEEE-CPMT in Zusammenarbeit mit IMAPS organisiert. Das Event im September in Hel-

sinki schließt sich an die erfolgreichen Veranstaltungen seit der ersten Konferenz 2006 in Dresden an. Später fanden ESTC in

Greenwich, Berlin und Amsterdam statt. Teilnehmer, Referenten und Aussteller kamen zuletzt aus 26 Ländern, womit man die Konferenzreihe wahrhaft international nennen kann.

Die Veranstalter rechnen damit, dass sich wieder etwa 300 Ingenieure, Manager und Wissenschaftler aus allen Bereichen der Elektronikindustrie sowie der relevanten Forschung und Entwicklung zusammenfinden. Die Finlandia Hall als Veranstaltungsort und die Stadt Helsinki bilden neben den fachlichen Highlights eine angenehme Atmosphäre für gemeinsamen Austausch und Arbeit. Helsinki ist eine pulsierende und charmante Großstadt an der baltischen Küste und bildet mit den benachbarten Städten Espoo und Vantaa einen Großraum mit 1,3 Millionen Einwohnern und dem wirtschaftlichen Zentrum von Finnland. Zahlreiche finnische und internationale Unternehmen der Elektronikindustrie haben dort ihren Sitz oder unterhalten Standorte. Neben hochrangiger



Industrie sind auch aus technischer Sicht wichtige Institute und Hochschulen im Raum Helsinki ansässig. IMAPS unterstützt die Konferenz der IEEE-CPMT und möchte Sie einladen, die Konferenz für Ihre Weiterbildung, zum Networking oder als Aussteller zu nutzen. Informationen zu den Möglichkeiten der begleitenden Ausstellung sowie einige Details zur Konferenz finden Sie bereits jetzt auf der Website <http://www.estc2014.eu>.

In Kürze werden die Programmdetails bekannt werden und sind dann auch dort abrufbar.

Als besonderes Extra dürfen wir mitteilen, dass IMAPS Deutschland-Mitglieder die gleichen vergünstigten Konferenzbeiträge erhalten können wie CPMT-Mitglieder.

■ ‚Call for Papers‘ für SEMICON Europa 2014 und Plastic Electronics 2014 ist eröffnet

Als führende europäische Veranstaltung der globalen Halbleiter- und Mikroelektronikindustrie wird die SEMICON Europa zukünftig zwischen den Standorten Grenoble/Frankreich und Dresden/Deutschland rotieren. Die diesjährige SEMICON vom 7. bis 9. Oktober in Grenoble umfasst nicht nur die Präsentation der neuesten Produkte und Technologien der Branche in Bezug auf die Herstellung von Halbleiter- und Mikroelektronik, sondern zeigt vielmehr auch neue Märkte entlang der Wertschöpfungskette. Diese umfassen elektronische Komponenten und Design wie auch Applikationen für Bildgebung, Leistungshalbleiter, Sicherheit und Medizintechnik.

Als Spiegel der neusten technologischen Entwicklungen bietet die SEMICON Europa 2014 auch in die-



sem Jahr neben der Ausstellung wieder eine umfangreiche und interessante Mischung aus Konferenzen, Fachveranstaltungen und Firmenpräsentationen. Bis zum 30. April 2014 ist der ‚Call for Papers‘ für die technischen Konferenzen geöffnet und es können Vorträge eingereicht werden, die das Augenmerk auf aktuelle Themenbereiche legen. In zielgerichteten Präsentationen sollen die neuesten Fortschritte und Perspektiven aufgezeigt werden sowie dem Publikum Rückblicke und Ausblicke über Märkte als auch technologische Entwicklungen gegeben werden.

Bis zum 30. April 2014 können Abstracts für folgende Konferenzen eingereicht werden:

- 16th European Manufacturing Test Conference (EMTC): ‚Test Innovations for a Competitive Edge‘
- International MEMS Industry Forum: ‚MEMS Inside: the Hidden Revolution‘
- Advanced Packaging Conference: ‚The Power of Packaging‘
- 450 mm Session (Semiconductor Technology Conference): ‚450 mm Innovations and Synergies for Smaller Diameters‘
- Plastic Electronics Conference 2014



■ Veranstaltungskalender

Ort	Zeitraum	Name	Veranstalter
Osaka	14.-16. April 2014	CICMT 2014	IMAPS, ACerS
Albuquerque	13.-15. Mai 2014	IMAPS HiTEC	IMAPS US
Oulu	9.-11. Juni 2014	Nordic Conference	IMAPS Nordic
Helsinki	16.-18. Sept. 2014	ESTC 2014	IEEE CPMT
München	23.-24. Okt. 2014	Herbstkonferenz 2014	IMAPS D
Friedrichshafen	13.-16. Sept. 2015	EMPC 2015	IMAPS Europa, IMAPS D

Für detaillierte Auskünfte besuchen Sie www.semi-coneuropa.org/www.plastic-electronics.org oder kontaktieren Sie Christina Fritsch, SEMI Europe, Tel. +49 30 3030 8077 18 oder per Email cfritsch@semi.org.

■ IMAPS Deutschland – Ihre Vereinigung für Aufbau- und Verbindungstechnik

IMAPS Deutschland, Teil der ‚International Microelectronics and Packaging Society‘ (IMAPS), stellt seit 1973 in Deutschland das Forum für alle dar, die sich mit Mikroelektronik und Aufbau- und Verbindungstechnik beschäftigen. Mit mehr als 300 Mitgliedern verfolgen wir im Wesentlichen drei wichtige Ziele:

- wir verbinden Wissenschaft und Praxis
- wir sorgen für den Informationsaustausch unter unseren Mitgliedern und
- wir vertreten den Standpunkt unserer Mitglieder in internationalen Gremien.

■ Proceedings

Die Proceedings des diesjährigen Seminars in Dresden zum Thema ‚Volumenintegration – Stapen, Falten, Vergraben‘, können auf CD zum Preis von



€ 55,-
erworben werden.

Die aktuelle CD-ROM enthält neben den 2014'er Proceedings auch die mehrerer früherer Herbst- und Frühjahrsveranstaltungen. Unsere Seminare sind traditionell themenorientiert und beschäftigten sich zuvor mit zu Themen wie ‚Medizintechnik- Herausforderungen an das Packaging‘, ‚Manche mögen's heiß – Power Electronic Packaging‘, oder ‚Ist Zuverlässigkeit noch bezahlbar?‘

Ihre Bestellungen richten Sie bitte an:

Ernst Eggelaar, c/o Microtronic GmbH,
Kleingrötzing, D-84494 Neumarkt-St.Veit,
Fax +49-8722-9620-30, ee@microtronic.de

Bitte beachten Sie, dass der angegebene Preis gemäß §4 Nr.22 UStG umsatzsteuerfrei ist und die verfügbare Anzahl begrenzt ist.

■ Impressum

IMAPS Deutschland e.V.

1. Vorsitzender:

Dr.-Ing. Martin Schneider-Ramelow

martin.schneider-ramelow@izm.fraunhofer.de

Schatzmeister

(bei Fragen zu Mitgliedschaft und Beitrag):

Ernst J. M. Eggelaar,

ee@microtronic.de



Ausführliche Kontaktinformationen zu den Vorstandsmitgliedern finden Sie unter www.imaps.de (Vorstand)